**附件一**

**台積電博士獎學金申請表（2024-05-02）**

**一、申請人基本資料 (以下僅供獎學金相關事宜之聯絡使用，不做其他用途)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | | | **性別** |  |
| **類別** | **🞏 準博士生（🞏學逕博** **🞏碩逕博：****○碩一上 ○碩一下 ○碩二上 ○碩二下）**  **🞏 博一生** | | | | |
| **博士** | **學校** |  | | **科系/主修** |  |
| **研究領域** |  | | | |
| **碩士** | **學校** |  | | **科系/主修** |  |
| **學士** | **學校** |  | | **科系/主修** |  |
| **聯絡電話** |  | | | | |
| **e-Mail** |  | | | | |
| **博士指導教授** |  | | **指導教授e-Mail** |  | |

**二、請勾選修習過之半導體相關課程**

|  |
| --- |
| **🞏 電子學 🞏 電路學 🞏 半導體元件物理 🞏 半導體(積體電路)製程技術**  **🞏 積體電路設計 🞏 數位電路設計 🞏 類比電路設計 🞏 電子材料/材料分析 🞏 薄膜製程 🞏 固態熱力學 🞏 近代物理 🞏 固態物理 🞏 分析化學 🞏 材料化學 🞏 電化學** |

**其中，印象最深的是哪一門課？(300字以內)**

|  |
| --- |
|  |

**三、請簡述擬研究領域/主題與「半導體產業」之關聯性。(300字以內)**

|  |
| --- |
|  |

**四、請列出在學成績(GPA)、英文檢定成績、曾獲獎項與特殊榮譽。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **是否參與過台積聯合研發計畫？** | | | |
| 🞏 否 | 🞏 是；計畫名稱： | | |
| **GPA**  🞏 大學： | 🞏 碩士： | **英文檢定成績**  🞏 檢定名稱： | 🞏 成績： |
| **其他獎項或特殊榮譽(扼要條列)：** | | | |

**五、請確認是否已備妥以下資料：**

🞏 獎學金申請表

🞏 個人完整履歷表

🞏 歷年學業成績單

🞏 博士學位研究計畫書

🞏 個人資料蒐集、處理及利用同意書

🞏 教授推薦信(第一階段審查加分項，最晚須於第二階段審查前提供)

🞏 英文檢定證明(第一階段審查加分項)

🞏 碩士論文成果／專題研究成果(第一階段審查加分項)

🞏 課外活動或服務歷程/成果(第一階段審查加分項)

確認無誤後，請將上述備審資料/文件之電子檔，透過電子郵件寄至「台灣積體電路製造股份有限公司 人才開發暨招募部」 高小姐 (Email: [chenkw@tsmc.com](mailto:chenkw@tsmc.com))。

若有任何問題，歡迎來電詢問 (03)563-6688 #752-3580。

**附件二**

**台積電博士獎學金**

**個人資料蒐集、處理及利用同意書**

您為申請台積電博士獎學金（下稱「本獎學金」），將提供台灣積體電路股份有限公司（下稱「台積電」或「本公司」）個人資料，為保障您的權益，本公司謹依個人資料保護法第八條第一項，告知您以下事項。若您於後勾選同意並簽署本同意書，即代表您已充分瞭解本同意書之內容並同意受其拘束：

1. **個人資料蒐集之目的**

本公司為處理您報名本獎學金相關事宜（包括且不限為報名管理、身分確認、審核活動聯繫等），並將您的資料建檔於本公司人才資料庫等目的，將蒐集、處理、利用您的個人資料。依據法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」之分類，上述本公司蒐集您個人資料之目的屬「人事管理(002)」、「契約、類似契約或其他法律關係事務(069)」、「教育或訓練行政(109)」、「產學合作(110)」「其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務(181)」等。

1. **個人資料之類別**

本公司僅會於本同意書第一條所定特定目的範圍內，蒐集您的個人資料。這些資料包括但不限於您的姓名、身分證字號、學校、電子信箱等可以辨識您本人之資料。依據法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」之分類，本公司蒐集您的個人資料之類別包括「辨識個人者(C001)」、「政府資料中之辨識者(C003)」、「個人描述(C011)」、「學校記錄(C051)」、「資格或技術(C052)」、「著作(C056)」、「學生（員）、應考人紀錄(C057)」、「工作經驗(C064)」等。

1. **個人資料利用之期間、地區、對象及方式**
2. 本公司將於第一條特定目的範圍內，以電子郵件或其他方式，在中華民國境內或境外蒐集、處理、利用您的個人資料。為達成第一條所列之目的，本公司得傳輸您之個人資料予本公司之從屬/控制公司（依公司法第369條之2之規定），及伺服器提供者等受本公司委託處理您個人資料之第三人。
3. 本公司將於本公司經營期間，且本同意書第一條目的尚存續時，利用及處理您的個人資料。
4. **您依個人資料保護法所得行使之權利及方式**
5. 就您提供予本公司之個人資料，您有權向本公司：(1)查詢或請求閱覽；(2)請求製給複製本；(3)請求補充或更正；(4)請求停止蒐集、處理或利用；(5)請求刪除的權利。
6. 您依本條第1項約定提出請求時，須檢附相關證明文件向本公司提出書面請求；就您查詢或請求閱覽個人資料或製給複製本時，本公司得酌收必要成本費用。您瞭解，若您要求本公司刪除、停止繼續使用您的個人資料，將可能影響您申請及受領本獎學金之資格。
7. **不提供個人資料對您權益之影響**

您可以自由決定是否提供您的個人資料予本公司，惟您亦瞭解如不完整提供該等資料，您將無法申請本獎學金。

□**我同意並瞭解上述台積電博士獎學金個人資料蒐集、處理及利用同意書所有內容，並擔保我所提供予台積電之資料均屬真實正確。**

聲明人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_＿＿＿

身 分 證 字 號：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_＿＿＿

通訊地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿